

POC-500

- AMD Ryzen™組み込みV1605B / V1807Bシリーズクアドコア15W / 45W CPU
- 25°C~70°Cの過酷な高温動作
- ネジロック付き4ギガビットPoE +ポート
- ネジロック付きUSB 3.1Gen1ポート4個
- 高速ストレージアクセス用のM.2 2280 MキーNVMe (Gen3 x2) ソケット
- DP + VGAデュアルディスプレイ出力
- フロントI/OアクセスとDINレール取付設計
- MezIO™対応

POC-400

- Intel®ElkhartLakeAtom®x6425Eクアドコア1.8GHz / 3.0GHz12Wプロセッサ
- 25°C~70°Cの堅牢なファンレス動作・2x 2.5GbE PoE +ポートと1x2.5GbEポート (ネジロック付き)
- 2x USB 3.1Gen1および2xUSB 2.0ポート (ネジロック付き)
- M.2 2280MキーSATAインターフェース
- 4096 x2160の解像度をサポートするデュアルDPディスプレイ出力
- フロントI/OアクセスDIN取付設計
- MezIO™対応

POC-300

- Intel®ApolloLakePentium®N4200およびAtom™E3950クアドコアプロセッサ
- ファンレスで頑丈なワイド温度動作 (-25°Cから70°C)
- 1つのGbEポートと2つのギガビットPoE +ポート
- 2つのUSB 3.1Gen1と2つのUSB2.0ポート
- DVI + VGAデュアルディスプレイ出力
- フロントI/OアクセスDIN取付設計
- MezIO™対応

POC-40

- Intel®ElkhartLakeAtom®x6211Eデュアルコアプロセッサ
- 49 x 89 x 112mmの非常にコンパクトなフォームファクタ
- 25°C~70°Cの堅牢なファンレス高温動作
- GigEポート2個、USB 3.1 Gen1ポート2個、USB2.0ポート2個
- M.2 2280MキーSATAストレージインターフェース
- 5G / 4Gモジュールをサポートする1つのM.2Bキー3042/3052ソケット
- WiFi 5 / WiFi6モジュール用のM.2Eキーソケット1つ
- RS-232 / 422/485モードのCOMポート1つとRS-232COMポート3つ

IBS Japan

アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社

<https://www.ibsjapan.co.jp/>
E-mail: info@ibsjapan.co.jp
営業時間 (土日・祝日を除く) 9:00 ~ 17:30

■ 厚木センター
〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー12F
TEL:046-234-9200 FAX:046-234-7861

■ 東京システムセンター
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南口ビル2F
TEL:03-5308-1177 FAX:03-5308-1188

■ 大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-6 新大阪橋本ビル4F
TEL:06-7176-9191 FAX:06-7176-9192

超コンパクトファンレスコンピュータ POCシリーズ

POCシリーズ | 広範囲動作温度 | 複数の拡張モジュールに対応



※ 掲載されているイラスト・画像についての著作権はneousysに帰属します。
※ 記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。
※ 製品内容・製品仕様は、予告なく変更いたします。最新情報については、お問い合わせください。

Product Introduction

超小型ファンレス組み込みコンピュータ

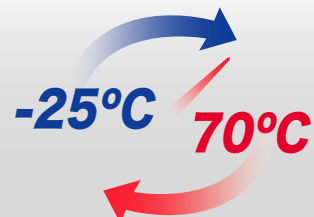
換気の悪い限られたスペースでの運用は、組み込みコンピュータであっても非常に困難です。Neosys Technology POCシリーズの超小型組み込みコンピュータは、こうした厳しい環境下での使用のために特別に設計されています。POCシリーズはファンレスで、非常にコンパクトな寸法(49x89x112mm)を備え、広範囲な温度条件(-25~70°C)で動作し、8~35VのDC入力に対応します。また、さまざまな柔軟なインターフェイス接続に対応しているため、理想的な限られたスペースへの設置が必要なあらゆる産業用アプリケーションに適しています。

特長



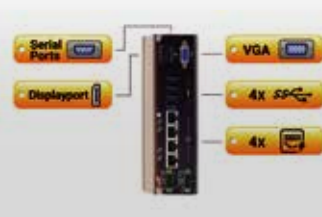
コンパクトサイズ

最小モデルのPOCは49x89x112mmと超コンパクト



広い動作温度範囲

特許取得済みのNeosys熱放散設計は、-25°Cから70°Cまでの真の広い温度動作を提供



豊富なI/Oポート

USB、COM、PoE、イーサネット、ビデオポートなどのさまざまなI/O接続に対応



拡張モジュール

Neosysが特許を取得したMezIO™インターフェイスにより、ユーザーはMezIO™モジュールを介して、2.5インチHDD / SSD用のSATAポート、絶縁型デジタルI/O、USB、PoE、COM、イグニッション制御を拡張可能

アプリケーション



ファクトリーオートメーション



自律移動ロボット(AMR)



マシンビジョン検査



エッジゲートウェイ

拡張モジュール: MezIO™モジュール

NeosysMezIO™インターフェイスは、高速コネクタを介してコンピュータ信号、電源レール、および制御信号を提供します。MezIO™モジュールは、Neosys組み込みシステムを専用アプリケーション向けのI/Oを備えたシステムに変換します。機械的および構造的に、MezIO™は、包括的なI/O機能を実装する際の信頼性を高めるために、3か所で固定するメザニン構造となっています。

	MezIO™-C180/181 8-port RS-232/422/485		MezIO™-D230/ D220 32/16-CH Isolated Digital I/O
	MezIO™-G4 4x GigE Ports by 4x Intel® I210 Controllers		MezIO™-U4-30 4 x USB 3.1 Gen 1 Ports
	MezIO™-R11/R12 SATA Oort for 2.5" HDD/SSD, 4-CH Isolated DI and 4-CH Isolated DO		MezIO™-V20 16-mode Ignition Power Control

拡張モジュール: スーパーキャパシタベースの電源バックアップモジュール

Neosysスーパーキャパシタ電源バックアップモジュールは、従来のUPSが直面する問題に対処します。65°Cまでの広い温度範囲で動作し、特許取得済みのCAPエネルギー管理テクノロジーを含めることで、リアルタイムモニタリングを介してスーパーキャパシタの使用率と消費電力を最大化し、適切なシャットダウンを開始、プロセスのデータ整合性を確保できます。

	SuperCAP ライフスパン構成		用途の広い動作モード		頑丈なワイド温度動作		特許取得済みの CAPエネルギー管理
	10年または500,000回の充放電サイクルに加えて、パラメーター構成ユーティリティの使用により、スーパーキャパシタの寿命を最大4.8倍まで延長可能		展開する環境に応じて、3つのモードから選択でき、それに応じて一般、イグニッション制御、イグニッションリレーを設定可能		Neosysのスーパーキャパシタ電源バックアップモジュールは、-25~65°Cの広い温度動作をサポートし、過酷な産業環境条件に最適		特許取得済みのCAPエネルギー管理テクノロジーは、リアルタイムの電力消費を監視して、予期しない停電時に適切なシャットダウンを保証

スーパーキャパシタベースの電源バックアップモジュール ラインナップ

【スタンドアロン】PB-9250J-SA
9250w.sスタンドアロンインテリジェントスーパーキャパシタベースの無停電電源バックアップモジュール
【スタンドアロン】PB-4600J-SA
4600w.sスタンドアロンインテリジェントスーパーキャパシタベースの無停電電源バックアップモジュール
【スタンドアロン】PB-2580J-SA
2500w.sスタンドアロンインテリジェントスーパーキャパシタベースの無停電電源バックアップモジュール

Selection Guide



Model Name	POC-500	POC-400	POC-300	POC-40		
Chassis	Dimensions (W x D x H)	64x 116x 176 mm(POC-515) 82x 118x 176 mm (POC-545)	56x 108x 153 mm	56x 108x 153 mm	49x 89x 112 mm	
	Weight	1.2 kg (POC-515) 1.4kg (POC-545)	0.96 kg	0.96 kg	0.6 kg	
	Chassis Construction	Aluminum alloy with heavy duty metal	Aluminum alloy with heavy duty metal	Aluminum alloy with heavy duty metal	Aluminum alloy with heavy duty metal	
System	Processor	AMD Ryzen V1605B (POC-515) AMD Ryzen V1807B (POC-545)	Intel® Elkhart Lake Atom x6425E quad-core	Intel® Atom E3950 quad-core Intel® Pentium N4200 quad-core	Intel® Elkhart Lake Atom x6211E dual-core	
	Graphics	Vega GPU with 8 compute units (POC-515) Vega GPU with 11 compute units (POC-545)	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics 505	Intel® HD Graphics	
	Memory	Up to 32GB DDR4-2400 (POC-515) Up to 32GB DDR4-3200 (POC-545)	Up to 32GB DDR4-3200	Up to 8GB DDR3L-1866	Up to 32GB DDR4-3200	
I/O Interface	PoE	IEEE 802.3at (25.5W) for 4x GbE ports	Optional (Port 2-3, IEEE 802.3at, 25.5W)	Optional (Port 2-3, IEEE 802.3at, 25.5W)	-	
	Ethernet	4x GbE by Intel® I350	3x 2.5GBASE-T by Intel® I225	3x GbE by Intel® I210	2x GbE by Intel® I210	
	Video Port	1x VGA 1x DisplayPort	2x DisplayPort	1x DVI-I	1x DisplayPort	
	Serial Port	1x RS-232/422/485 3x 3-wire RS-232	1x RS-232/422/485 3x 3-wire RS-232	1x RS-232/422/485 3x 3-wire RS-232	1x RS-232/422/485 3x 3-wire RS-232	
	USB 2.0	-	2	2	2	
	USB 3.1 Gen 1	4	2	2	2	
	Audio	1x Mic-in and speaker-out	1x Mic-in and speaker-out	1x Mic-in and speaker-out	1x Mic-in and speaker-out	
	Digital I/O	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	-	
	Storage Interface	SATA HDD	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	-
		mSATA	-	-	1	-
M.2 (M-key)		1	1	-	1	
Expansion Bus	Mini PCI-E	1	-	1	-	
	M.2 (B-key/E-key)	-	1x M.2 2330 E-key	-	1x M.2 3042/3052 B-key 1x M.2 2230 E-key	
	SIM	1	-	1	1	
Power Supply	MezIO™	Yes	Yes	Yes	-	
	DC Input	8-35V DC	8-35V DC	8-35V DC	12-20V DC	
	Ignition Control	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	Optional via MezIO™ module	-	
Environmental	Operating Temperature	-25° C ~ 70° C	-25° C ~ 70° C	-25° C ~ 70° C	-25° C ~ 70° C	
	Certification	CE/ FCC	CE/ FCC	CE/ FCC	CE/ FCC	